



# 2024年度 第2四半期 決算説明会 イビデン株式会社 (4062)

2024年11月1日

**このプレゼンテーション資料には、2024年10月31日現在の将来に**

**関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。**

**世界経済・競合状況・為替変動等にかかわるリスクや不確定要因**

**により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。**

# 2024年度上半期 実績



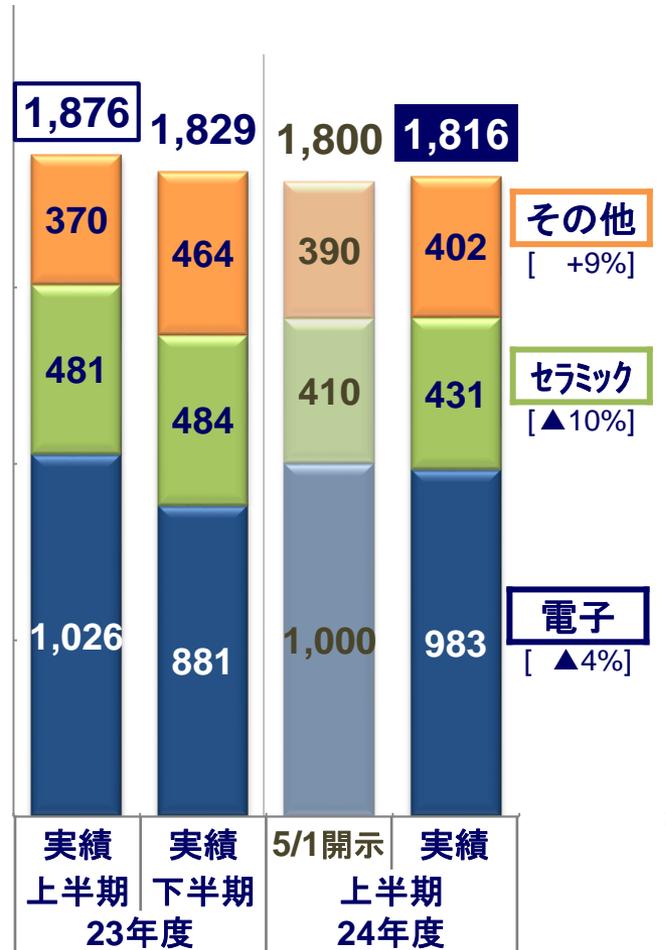
# 2024年度(上半期) 売上高・営業利益・純利益 実績

## 売上高

[ ]は  
前年同期比

前年同期比  
▲3.2%

(億円)



## 営業利益

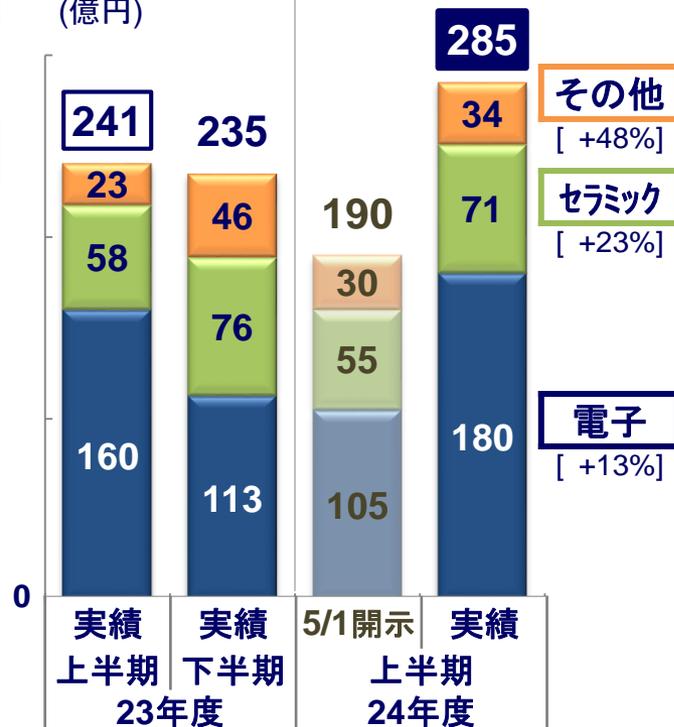
[ ]は  
前年同期比

営業利益率

前年同期比  
+18.4%



(億円)



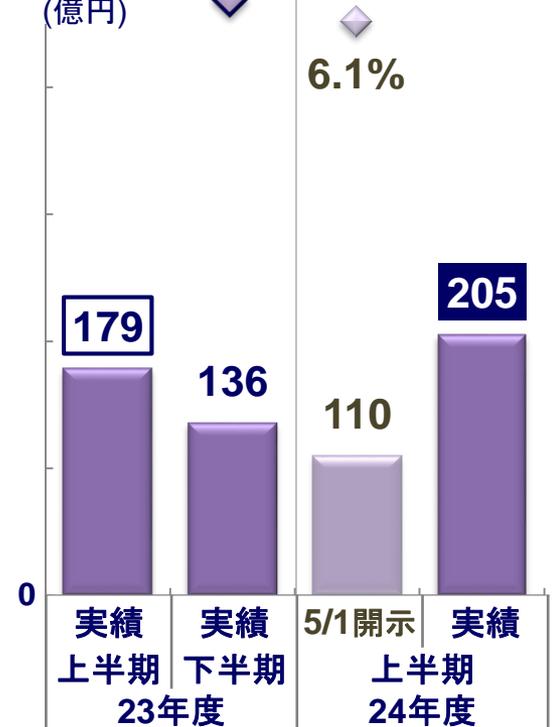
## 純利益

純利益率

前年同期比  
+14.7%



(億円)



為替(ドル)

為替(ユーロ)

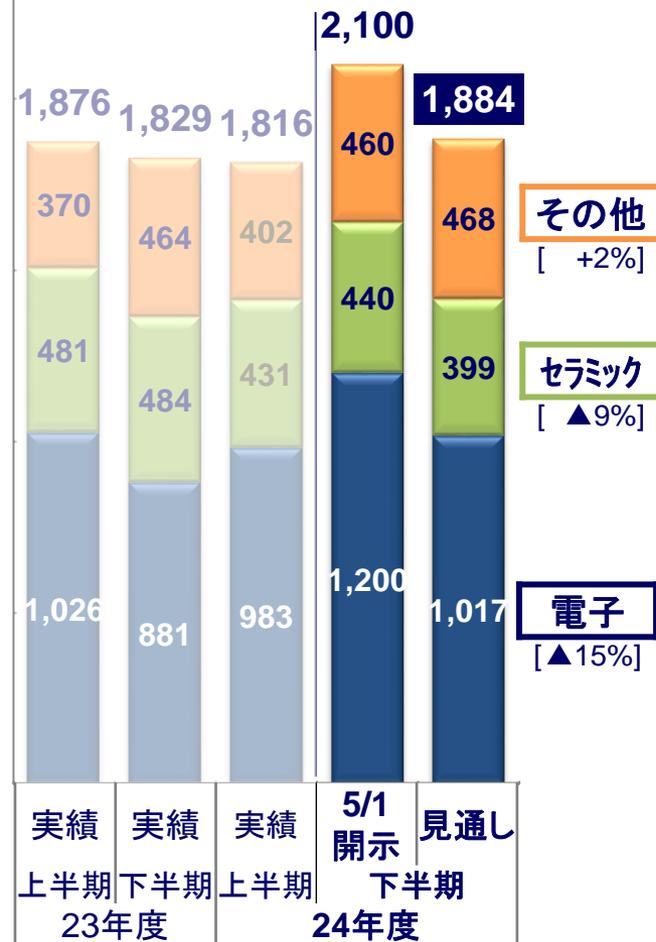
# 2024年度下半期 見通し

# 2024年度(下半期) 売上高・営業利益・純利益 見通し

## 売上高

24下期 5/1開示比 ▲10%

(億円)

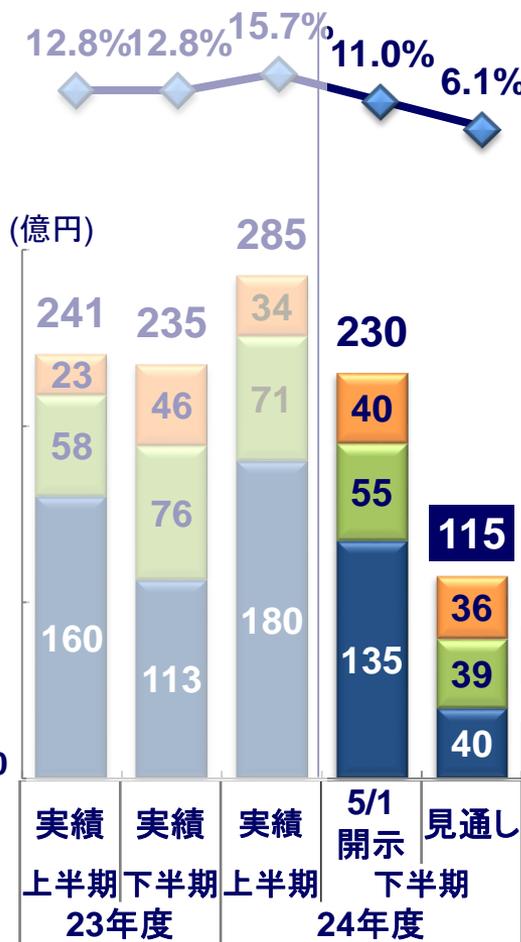


その他 [ +2% ]  
セラミック [ ▲9% ]  
電子 [ ▲15% ]

## 営業利益

営業利益率

24下期 5/1開示比 ▲50%

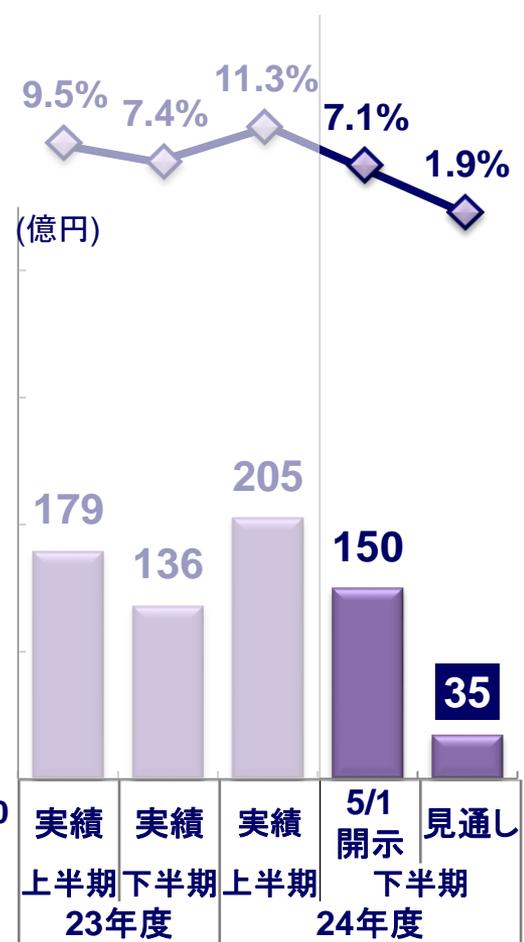


その他 [▲11%]  
セラミック [▲29%]  
電子 [▲70%]

## 純利益

純利益率

24下期 5/1開示比 ▲77%



138	147	153	140	145	為替(ドル)
150	158	165	150	155	為替(ユーロ)

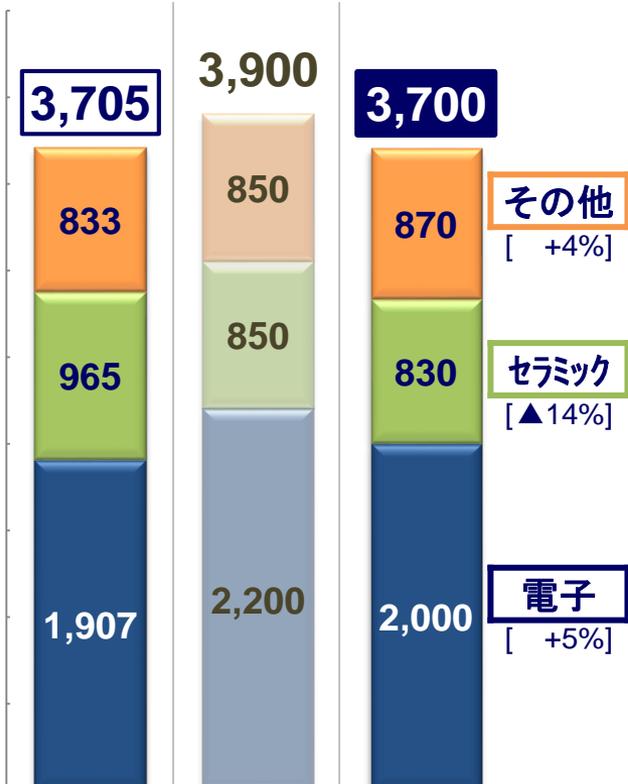
# 2024年度(通期) 売上高・営業利益・純利益 見通し

## 売上高

[ ]は  
23年度比

(億円)

23年度比  
▲0.1%

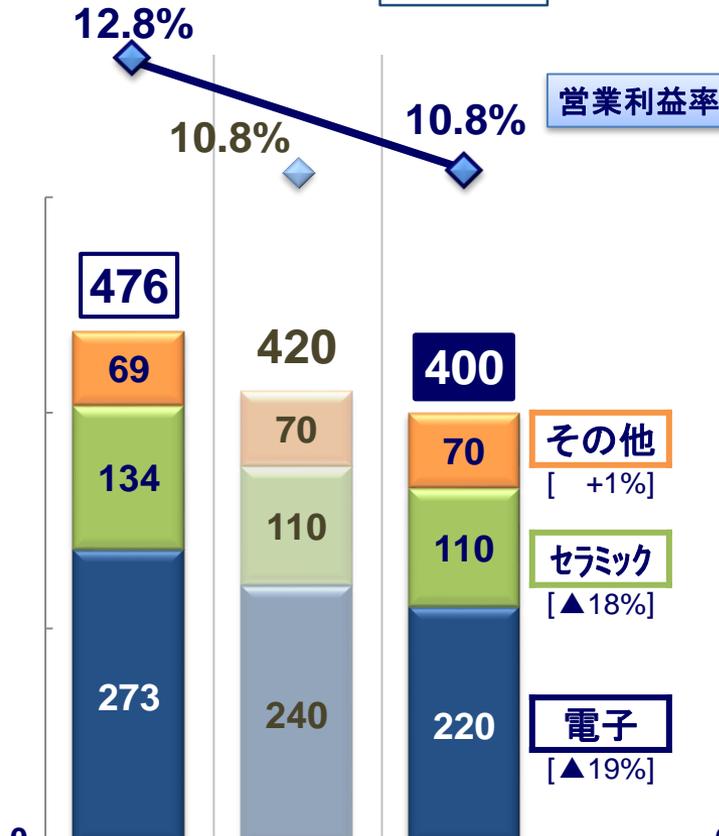


## 営業利益

[ ]は  
23年度比

(億円)

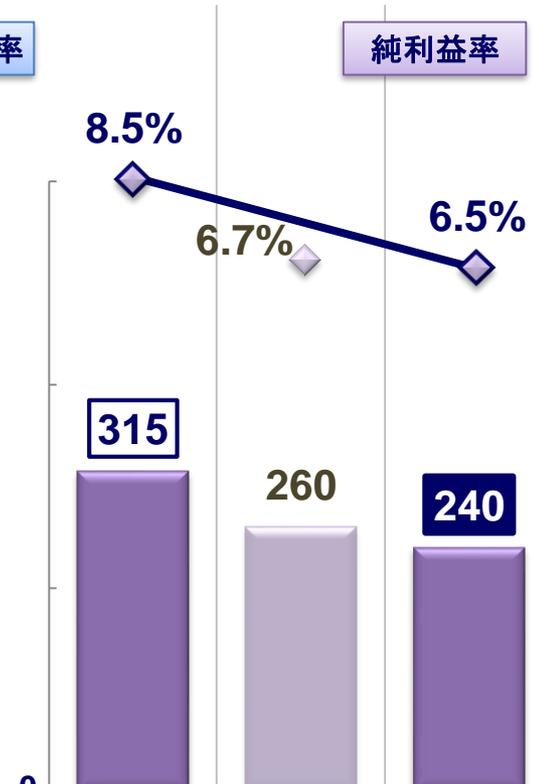
23年度比  
▲16%



## 純利益

(億円)

23年度比  
▲24%



実績 23年度	5/1開示 24年度	見通し 24年度	
142	140	149	為替(ドル)
154	150	160	為替(ユーロ)

# 市場見通しと 当社事業展望

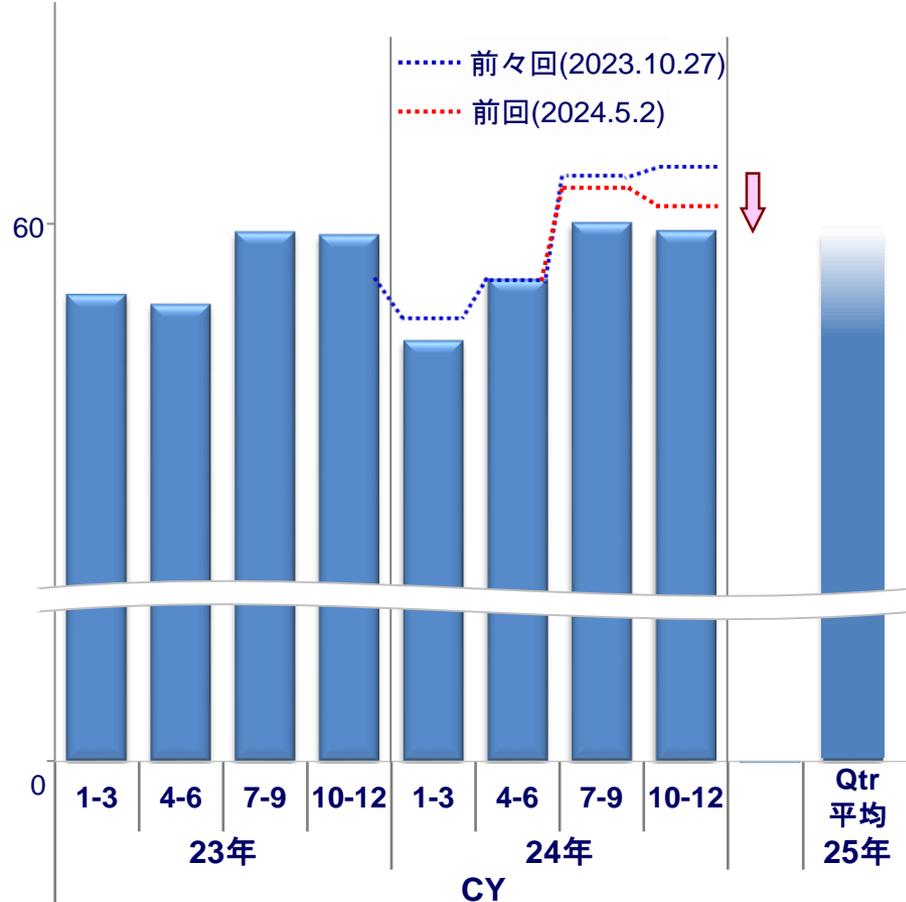
# 電子市場の動向と変化

- パソコン市場: OS終了に伴う買換需要は期待されるものの、製品のコモディティ化が進展
- サーバー市場: AI向けは需要拡大が継続するも、汎用サーバーの需要回復は不透明

## パソコン市場

(外部調査会社の情報を基に推定)

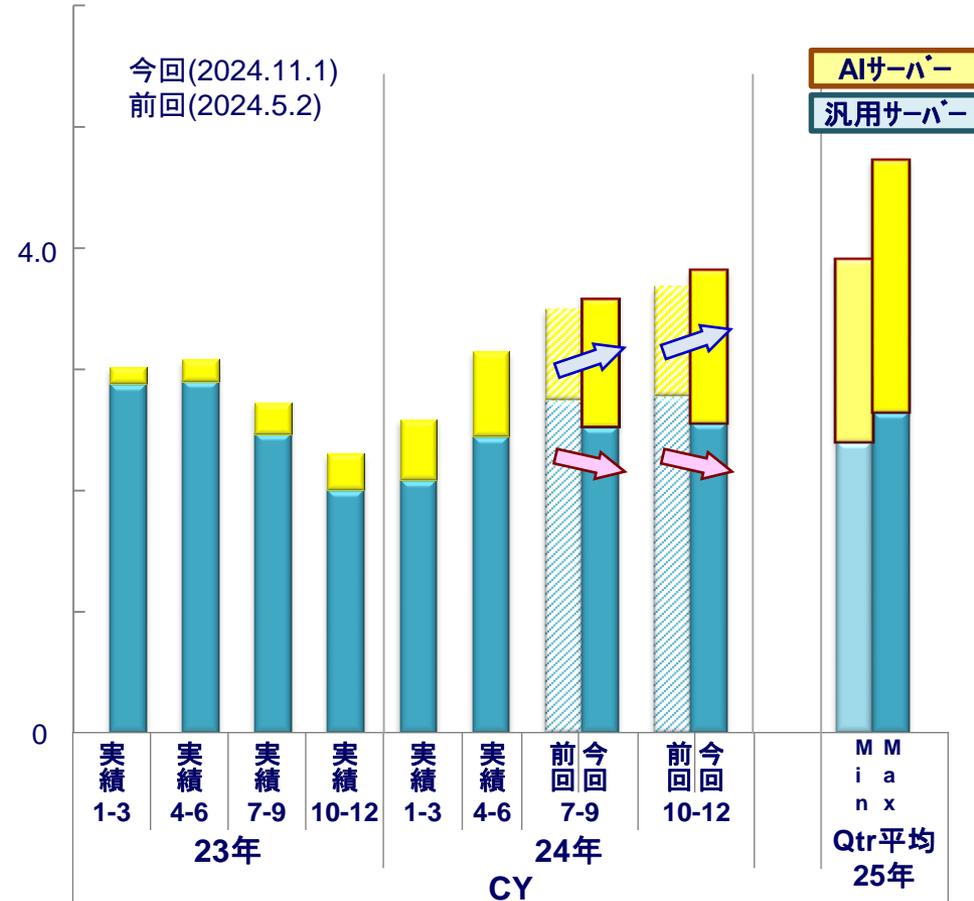
(百万台)



## サーバー(汎用+AI)市場

(外部調査会社の情報を基に推定)

(百万台)



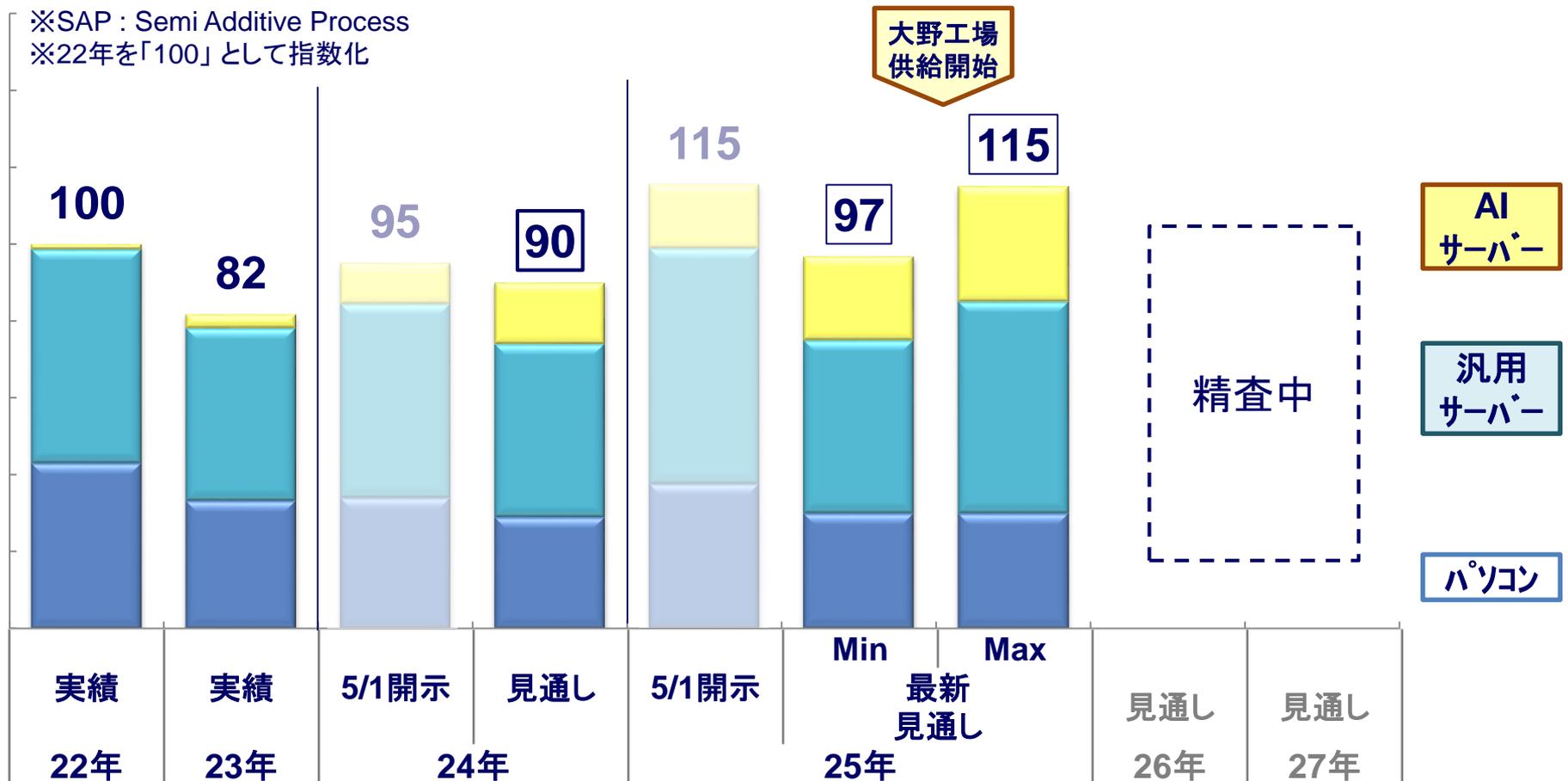
# ICパッケージ基板の需要見通しと投資計画

- AI向け需要拡大と顧客比率の変化を受けて、大野工場は計画通り立上げる
- 既存工場を含む生産能力のフレキシビリティを向上し、高付加価値品の受注最大化を目指す
- 市場/競争環境の変化を受け、中期需要見通しと河間工場の稼働タイミングを精査する

## SAP\*需要(面積)

(顧客情報等を基に推定)

※SAP : Semi Additive Process  
 ※22年を「100」として指数化



- AIサーバー
- 汎用サーバー
- パソコン

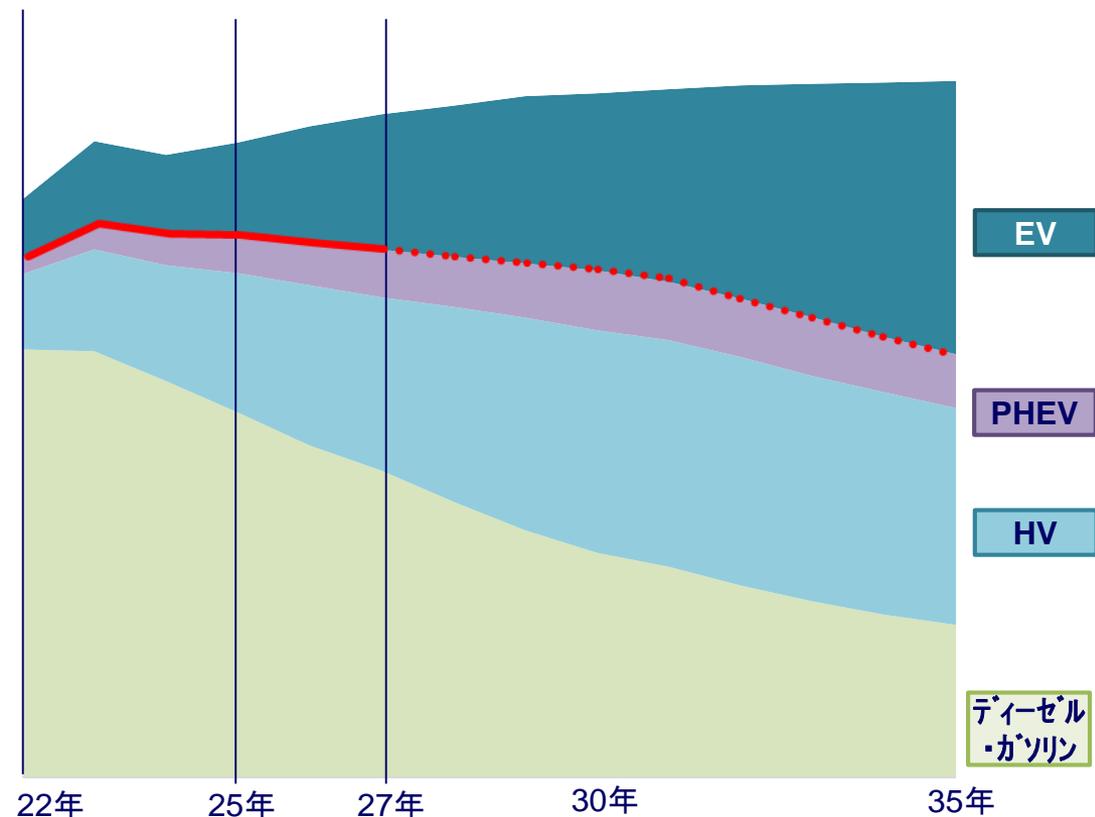
# セラミック市場の動向と変化

- 内燃機関搭載車は一定シェアを維持するも、中国商用車(HD)市場の回復動向を見極める
- 足もとのSiCパワー半導体需要はEV減速を受け調整局面、中期的な需要見通しを精査する

## パワートレイン市場

(外部調査会社の情報を基に推定)

(百万台)

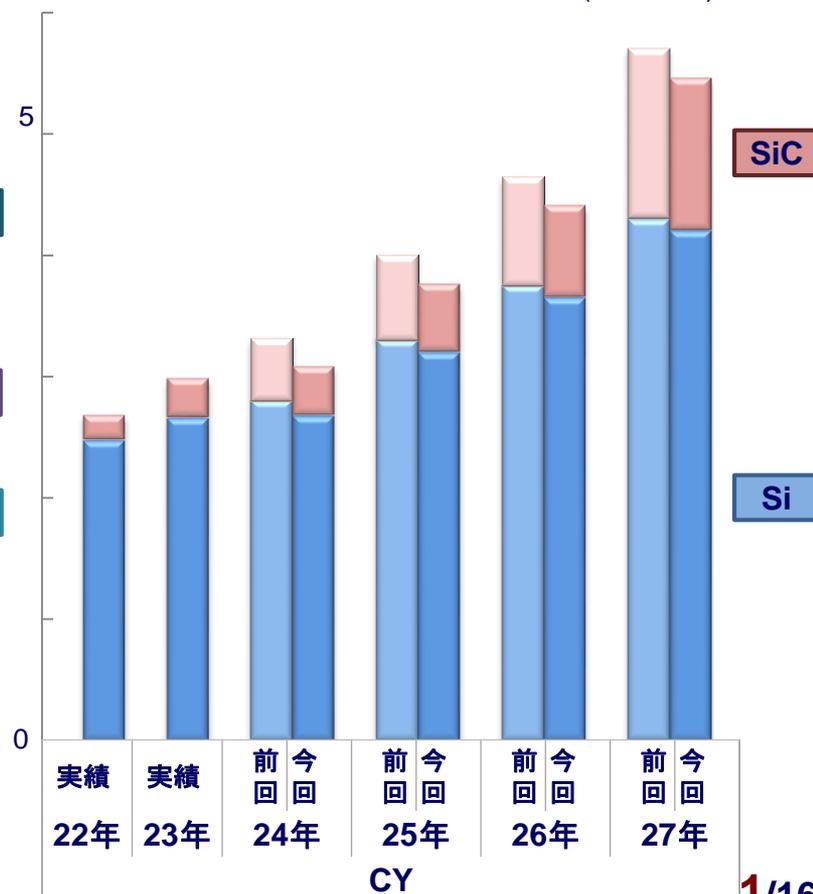


## パワー半導体市場

(外部調査会社の情報を基に推定)

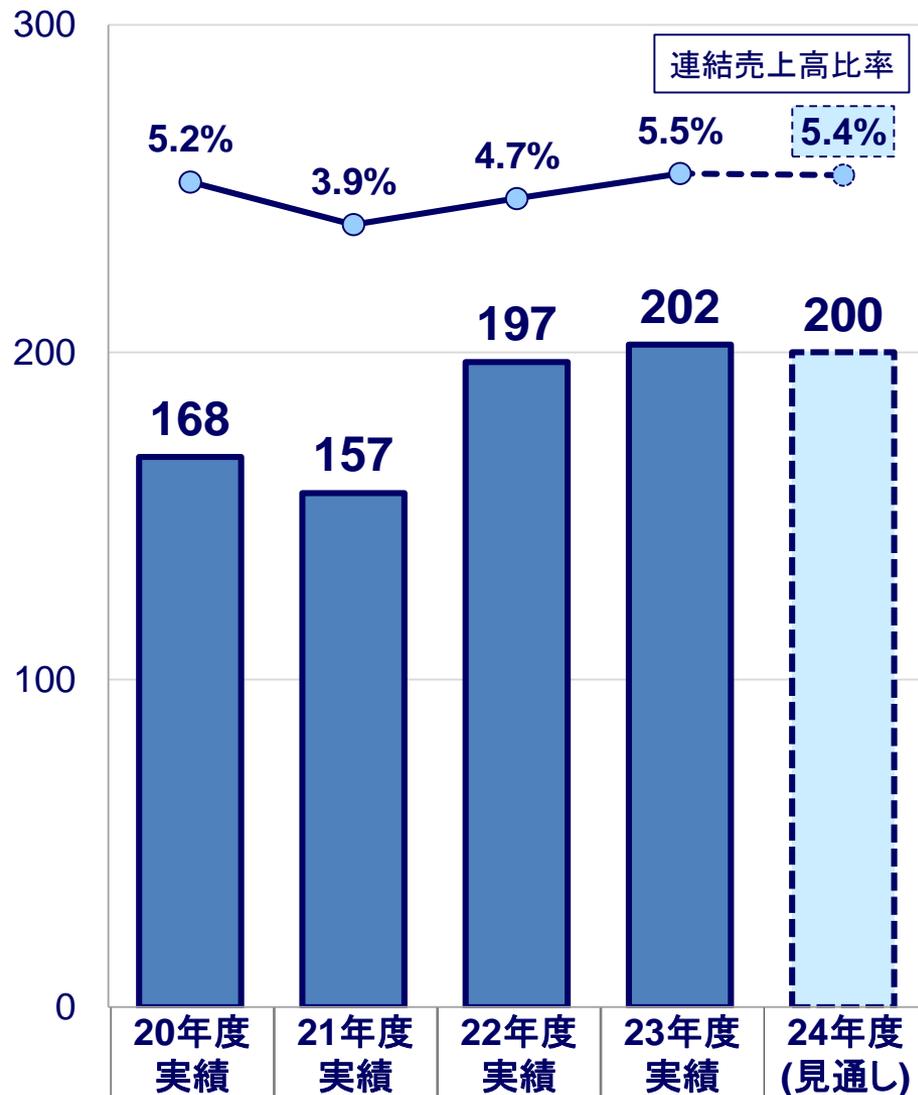
(兆円)

今回(2024.10.31)  
前回(2024.5.2)



# 次の成長に向けた研究開発活動

## 研究開発費の推移(実績・計画)

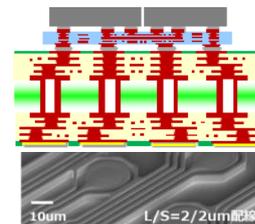


## 当社の研究開発領域

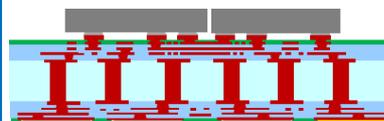
### エレクトロニクス領域

- ▶ 次世代3Dパッケージ
- ▶ ガラスコア基板
- ▶ 光デバイス

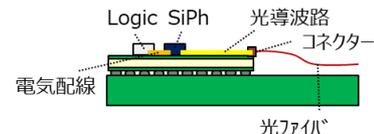
#### 【次世代PKG】



#### 【ガラスコア基板】



#### 【光デバイス】



### NEV領域

- ▶ NEV向け部材
  - ・ LiB安全部材
  - ・ 耐熱断熱材
  - ・ 耐熱絶縁部材
- ➔ 27年度 売上目標 100億円



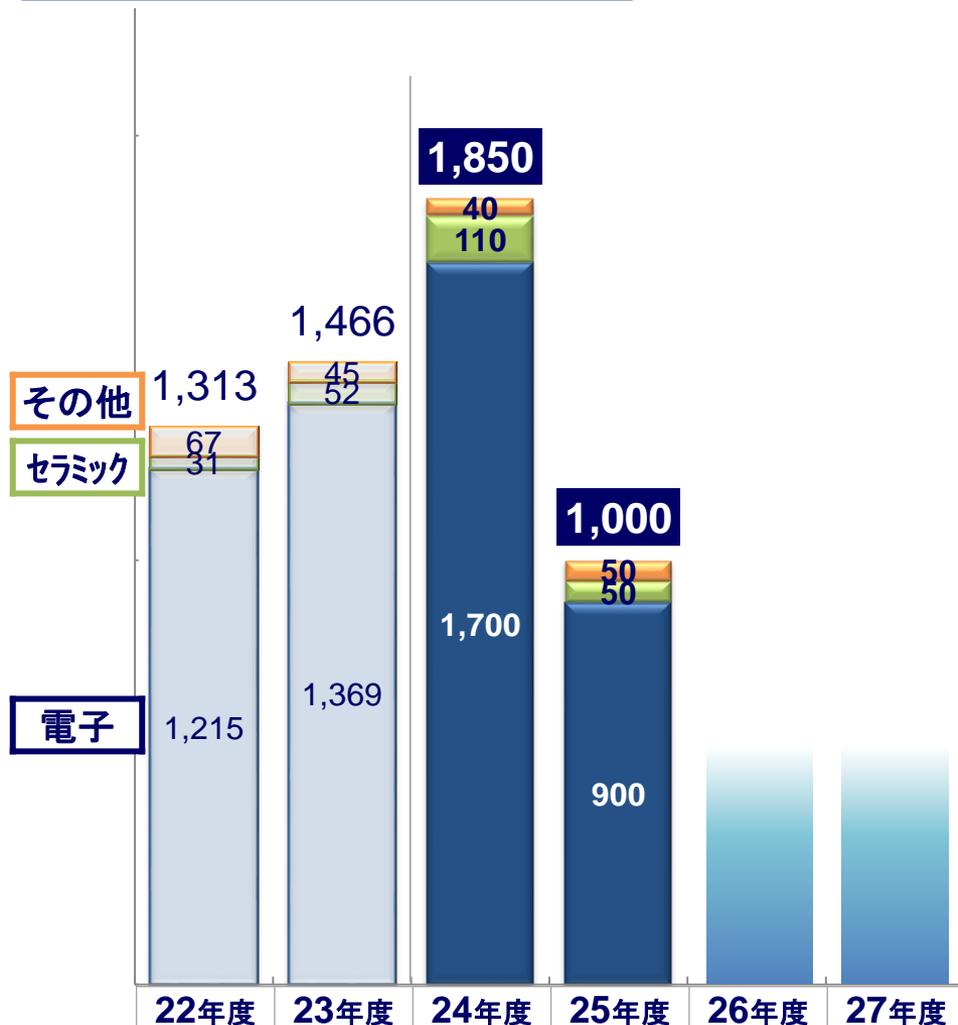
### 新領域

- ▶ 植物活性化材 (LEAF ENERGY)
- ▶ CO<sub>2</sub>固定化技術

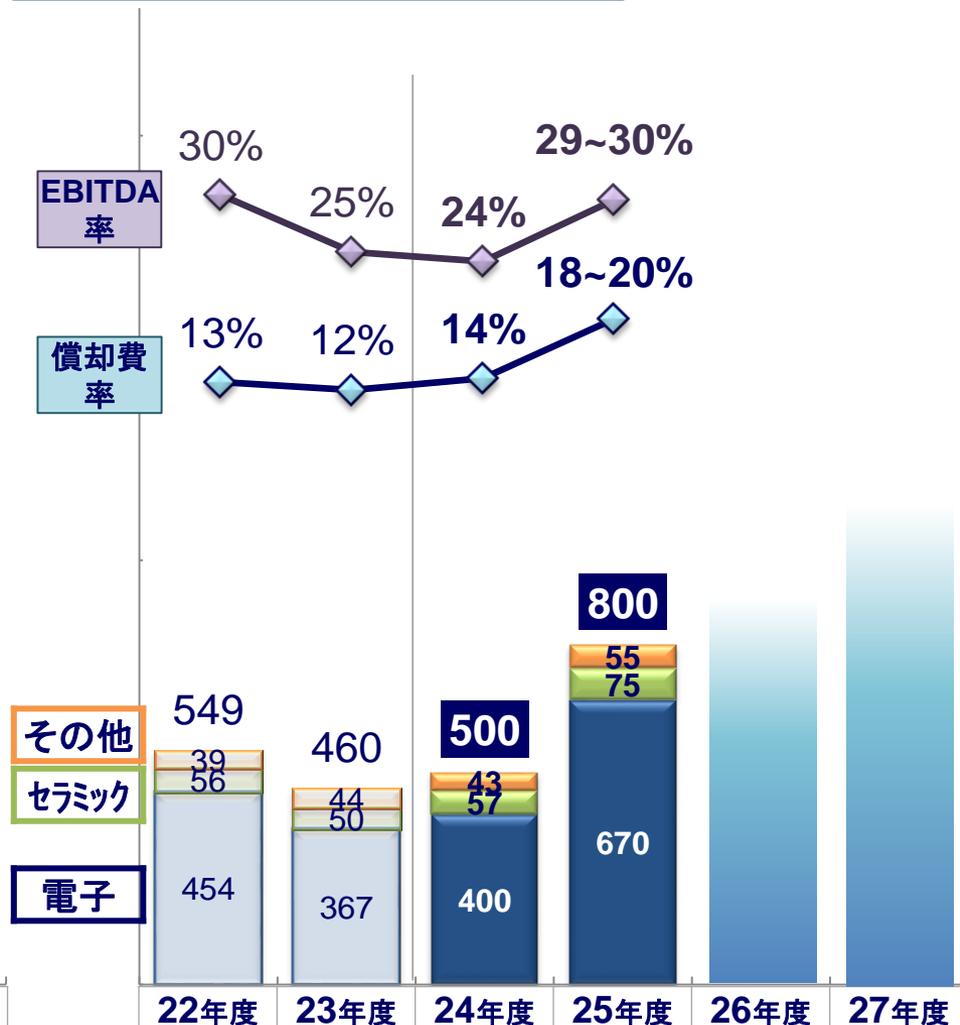


# 設備投資(検収)額・減価償却費の計画

## 設備投資額 (億円)



## 減価償却費 (億円)

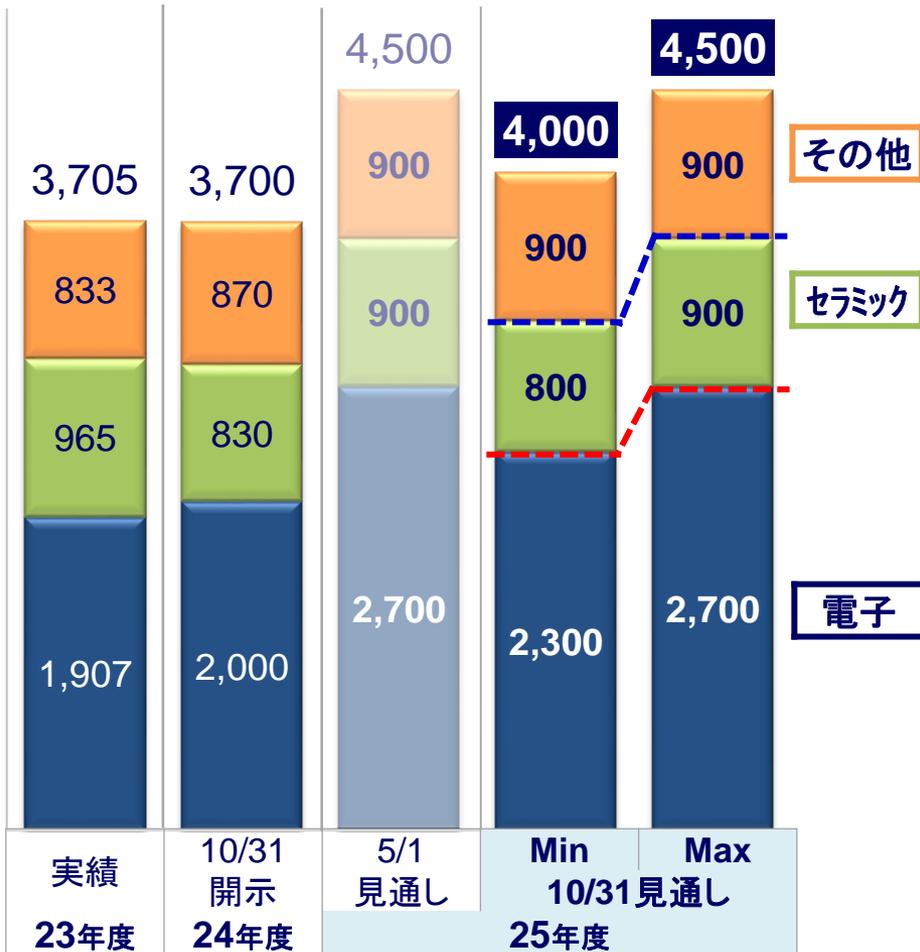


# 中期業績見通し

□ 電子事業における大きな事業環境変化を踏まえ、25年度業績がトラインを下方修正する

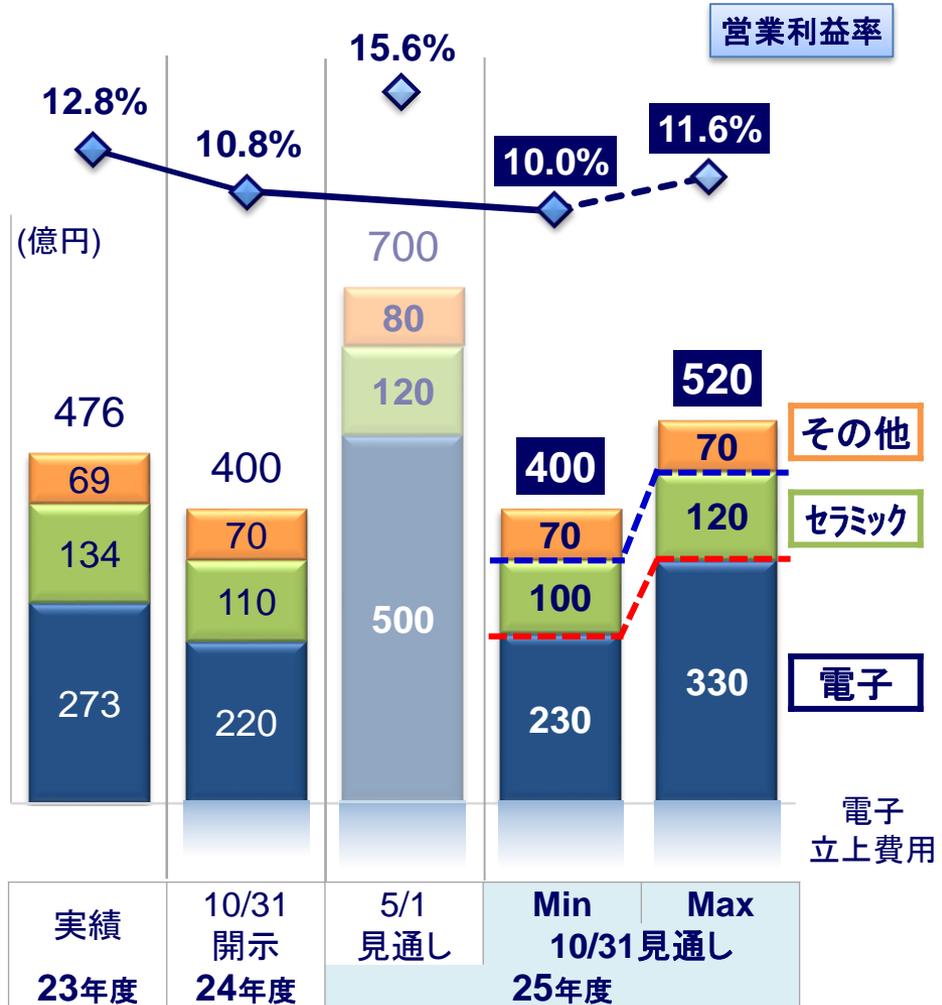
## 売上高

(億円)



## 営業利益

(億円)



電子  
立上費用

# 株主還元

# 資本配分と株主還元

- 足もとの市況変化に確実に対応しつつ、中長期の需要拡大に備え、ICパッケージ基板の大型投資を継続実施する
- 株主還元は、安定配当を継続する

## 一株当たり配当金

